

公開招標報價單或企劃書公告

[標案名稱] **半導體封裝製程場域高壓電源增設工程**

[標案案號] LHU1140702W01 [公告日] 114/07/21

[招標狀態] **第二次公開招標** [傳輸次數] 02

[標的分類代碼及名稱] **工程類**

[單位名稱] **半導體系** [聯絡人] 營繕組何先生

[財物採購性質] 買受,定製 [決標方式] 最低標

[採購金額級距] **未達公告金額**

[押標金額度] **\$92,000 元整** [後續擴充] 否

[是否依機關異質採購最低標作業須知辦理] 否

[依據法條] 採購法第 49 條 [辦理方式] 補助

[法人團體辦理適用採購法案件之依據法條] 採購法第 4 條

[是否已辦理公開閱覽] 否 [是否屬特殊採購] 否

[是否屬共同供應契約採購] 否 [是否屬統包] 否

[是否依政府採購法施行細則第 64 條之 2 辦理] 否

[是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)] 否

[是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證] 否

[是否適用採購法第 104 條或 105 條或招標期限標準第 10 條或第 4 條之 1] 否

[是否依據採購法第 106 條第 1 項第 1 款辦理] 否

[是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC)] 否

[招標文件領取地點] 本校總務處營繕組

[招標文件售價及付款方式] 詳見廠商資格摘要

[截止投標] 114/08/06 10:00 [投標文字] 正體中文

[開標時間] 114/08/06 13:30 [是否刊登公報] 是

[是否於招標文件載明優先決標予身心障礙福利機構團體或庇護工場] 否

[履約期限] 114 年 11 月 11 日(含)

[本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本] 是

[是否訂有與履約能力有關之基本資格] 是(廠商信用證明)

[是否受機關補助] 是

[附加說明]

[廠商資格摘要]

一、廠商登記或設立之證明。

二、廠商納稅證明：營業稅繳款收據或最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯，如不及提出最近一期得以前一期之納稅證明代替之。新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函及申領統一發票購票證相關文件代之。

三、廠商信用證明：經票據交換機構或受理查詢之金融機構於截止投標日之前半年內所出具之非拒絕往來戶及最近三年無退票記錄之證明、會計師簽證之財物報表或金融機構或徵信機關出具之信用證明。

四、押標金：新台幣 **92,000 元整**

[招標文件領取方式及地點]

1.以郵寄方式購買或親自到本校總務處營繕組購買，「郵寄購買者請另附郵局便利袋」。

2.暑假時間：**星期一至星期五**(每日早上 09:00 至下午 16:00 時止)。

[招標文件售價及付款方式] 招標文件售價新台幣 **100 元整**[郵寄購買者請另附 65 元回郵信封或郵局便利袋]

[本案申購單位聯絡方式] 營繕組-何文定 電話：(02)8209-3211 分機 3622

[是否訂有與履約能力有關之基本資格] 否

[是否刊登英文公告] 否

[疑義、異議受理單位] 龍華科技大學

[申訴受理單位] 行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會 (地址：110 臺北市信義區松仁路 3 號 9 樓、電話：02-87897530、傳真：02-87897514)

[檢舉受理單位]

*桃園縣調查站 (地址：330 桃園市桃園區縣府路 19 號;桃園郵政 60000 號信箱、電話：03-3328888)

*法務部廉政署 (地址：104 臺北市中山區松江路 318 號 7 樓;台北郵政 14-153 號信箱、電話：0800286586、傳真：02-25621156)

*中央採購稽核小組 (地址：110 臺北市信義區松仁路 3 號 9 樓、電話：02-87897548、傳真：02-87897554)

[機關名稱] 龍華科技大學

[機關代碼] 3.10.90.26

[機關地址] 333 桃園市龜山區萬壽路一段 300 號

[電子郵件信箱] af055@mail.lhu.edu.tw

[聯絡電話] (02)82093211 分機 3622

[傳真號碼] (02)82091476

[是否須繳納押標金] 是

[預計金額是否公開] 否

[預算金額是否公開] 否

[是否複數決標] 否

[是否訂有底價] 是

[是否採行協商措施] 否

[是否依據採購法第 99 條] 否

[歸屬計畫類別] 非屬愛台十二項計畫

[是否含特別預算] 否

[是否適用 WTO 政府採購協定(GPA)] 否

[是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP)] 否

[是否提供電子領標] 否

[是否提供電子投標] 否

[收受投標文件地點] 本校總務處營繕組

[開標地點] 本校法民大樓六樓會議室

[履約地點] 桃園市(非原住民地區)

[本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本] 是

工程規格說明清單

工程名稱：半導體封裝製程場域修繕房屋及建築-高壓電源增設工程

備註：各項設備、材料均可提送同等品。